

「SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)／次世代パワーエレクトロニクス」
委託テーマ及び予定先一覧

研究開発 項目	テーマ名	委託予定先(順不同)
I	SiC 次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人京都大学 国立大学法人大阪大学 一般財団法人電力中央研究所
	ハイブリッド自動車向けSiC耐熱モジュール実装技術の研究開発	学校法人早稲田大学 国立大学法人九州工業大学
II	GaN 縦型パワーデバイスの基盤技術開発	国立大学法人京都大学 三菱化学株式会社 住友電気工業株式会社 株式会社豊田中央研究所 富士電機株式会社 パナソニック株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人大阪大学 国立大学法人北海道大学 国立大学法人名古屋大学 国立大学法人福井大学 国立大学法人京都工芸繊維大学 国立大学法人筑波大学 国立大学法人東北大学
III	次世代パワーモジュールを使用したパワーエレクトロニクス機器とその統合システムの包括的研究開発	国立大学法人東京工業大学 公立大学法人首都大学東京 国立大学法人大阪大学 国立大学法人千葉大学 国立大学法人名古屋工業大学 国立大学法人横浜国立大学 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北海道大学 国立大学法人山口大学 三菱電機株式会社 富士電機株式会社
	EV モータ駆動用機電一体インバータの研究開発	学校法人芝浦工業大学

IV	超高次非線形誘電率顕微鏡法を用いた SiC 基板材料及びパワーエレクトロニクス素子の高性能化に資する評価技術の開発	国立大学法人東北大学
	材料科学に基づく 4H-SiC 上の高品質ゲート絶縁膜形成手法の研究開発	国立大学法人東京大学
	酸化ガリウムパワーデバイス基盤技術の研究開発	独立行政法人情報通信研究機構 株式会社タムラ製作所 国立大学法人東京農工大学 新日本無線株式会社 株式会社シルバコ・ジャパン
	パワーデバイス用ダイヤモンド合成基盤技術の研究開発	独立行政法人物質・材料研究機構 国立大学法人東京工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所 コーンズテクノロジー株式会社
	ダイヤモンドパワーデバイス用ウエハの研究開発	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人千葉大学 国立大学法人大阪大学
	SiC パワーデバイス応用による低容量小型パワー集積回路開発およびパワープロセッシング技術の研究開発	国立大学法人京都大学 学校法人千葉工業大学 学校法人東京電機大学